



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 Octobre 2026

SLAM CONFERENCE 2026 DÉVOILE SON PROGRAMME :

*TROIS JOURS AU CŒUR DES INNOVATIONS ET
DES DÉFIS DE LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE*

Du 25 au 27 novembre 2026, Angers accueillera la première édition de SLAM Conference, le nouveau rendez-vous technique de la filière de la carte électronique. Avec 41 conférences, 2 tables rondes et une cinquantaine d'intervenants issus de l'industrie et de la recherche, l'événement propose un programme à l'état de l'art dédié aux innovations technologiques et aux défis de compétitivité, de fiabilité et de durabilité.

Co-organisé par Inventec Performance Chemicals, l'institut IFTEC et We Network, avec le soutien de la Fédération de l'Électronique Française, SLAM Conference dévoile un programme sélectionné par un comité technique de 15 experts, privilégiant les avancées technologiques, les travaux de recherche et les retours d'expérience industriels.

UN PROGRAMME TECHNIQUE POUR EXPLORER LES GRANDES TRANSFORMATIONS DE L'ÉLECTRONIQUE

Le programme couvre six grandes thématiques de la chaîne de valeur de la carte électronique : conception (DfX), PCB et substrats, process d'assemblage, test et Smart Factory, fiabilité et qualité des assemblages, durabilité et circularité. Parmi les nombreux sujets abordés, plusieurs tendances majeures se dégagent.

La conception électronique au service de la performance industrielle.

Les conférences aborderont la conception sous l'angle de l'industrialisation : prise en compte des contraintes de fabrication et de test dès l'amont (DfX), apport de l'intelligence artificielle, gestion thermique, conception pour environnements sévères et production en petites et moyennes séries. L'objectif : des cartes plus fiables, plus robustes et plus compétitives.

L'automatisation et l'intelligence artificielle au service de la performance industrielle.

La digitalisation des lignes CMS, l'automatisation des flux de composants ou encore l'intégration de l'IA dans les processus de fabrication seront au cœur des échanges. Des retours d'expérience industriels permettront d'illustrer concrètement ces transformations.

Les nouvelles technologies de fabrication et d'assemblage.

Du brasage sous vide aux nouvelles formulations d'alliages, en passant par le frittage, les procédés laser et les technologies de fabrication additive de PCB, les conférences présenteront de nouvelles manières de répondre aux exigences croissantes de performance des cartes électroniques tous secteurs confondus.

La fiabilité des assemblages dans les environnements exigeants.

Tenue aux contraintes thermomécaniques, protection contre l'humidité, fiabilité des modules de puissance ou encore durée de vie des assemblages pour les applications spatiales : autant de problématiques techniques qui seront explorées à travers des travaux d'experts et des applications industrielles.

La durabilité et la circularité de l'électronique.

Matériaux alternatifs et biosourcés, écoconception, recyclabilité des cartes, réemploi des composants ou encore évolution de la réglementation PFAS : le programme donnera également une place importante aux solutions permettant de réduire l'empreinte environnementale de l'électronique.

COMPÉTITIVITÉ, SUPPLY CHAIN ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL : DES ENJEUX COLLECTIFS AU CŒUR DES ÉCHANGES

Au-delà des conférences techniques, plusieurs temps forts permettront de prendre de la hauteur sur les enjeux stratégiques de la filière.

Le jeudi 26 novembre, THALES ouvrira la journée avec une keynote intitulée « Carte électronique : peut-on être collectivement compétitif ? », posant la question des leviers de compétitivité à l'échelle de l'écosystème industriel.

Le vendredi 27 novembre, une table ronde consacrée à la supply chain PCB réunira les acteurs de la filière autour des défis actuels liés à la chaîne d'approvisionnement des circuits imprimés et aux enjeux de souveraineté.

Une seconde table ronde portera sur les données environnementales et l'analyse du cycle de vie (ACV), deux enjeux essentiels pour accompagner la transition environnementale de l'industrie électronique.

UN RENDEZ-VOUS FÉDÉRATEUR POUR LES EXPERTS ET INDUSTRIELS DE L'ÉLECTRONIQUE

Pendant trois jours, SLAM Conference rassemblera à Angers les acteurs de toute la chaîne de la carte électronique, de la conception à l'assemblage : grands groupes industriels, entreprises spécialisées, centres techniques et organismes de recherche.

L'événement fera également une large place aux échanges entre participants, avec un espace d'exposition dédié aux innovations et solutions industrielles, une soirée d'accueil le 25 novembre au Musée des Beaux-Arts d'Angers et un dîner de gala le 26 novembre aux Greniers Saint-Jean.

Un événement soutenu par les acteurs de la filière.

Pour cette première édition, SLAM Conference bénéficie du soutien de plusieurs entreprises de référence de l'industrie électronique, engagées aux côtés des organisateurs pour faire de cet événement un lieu de partage des connaissances et de rencontres entre professionnels.

Parmi elles figurent *Lacroix, Thales, Micronique*, mais aussi *Glenair, C.I.F, Alliance Electronics, Metcal, Serma Technologies* et *Global Electronic Association*.

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS

SLAM Conference 2026 — Du 25 au 27 novembre 2026

Centre de Congrès Jean-Monnier, Angers

Le programme détaillé, les intervenants et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site officiel :

www.slam-conference-electronique.fr

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 novembre 2026.

À PROPOS DES CO-ORGANISATEURS

We Network est à la fois le centre technique de référence sur l'assemblage électronique et un cluster d'industriels, fédérant un écosystème de 170 acteurs de l'Industrie, de la Recherche et de la Formation. En tant que Tiers de confiance, We Network accompagne startups, PME et ETI pour accélérer et sécuriser leurs projets industriels.

Inventec Performance Chemicals est un fournisseur de matériaux de brasage, de nettoyage, de revêtement et de refroidissement pour des applications électroniques touchant de multiples secteurs, du médical à la défense en passant par l'automobile, l'aéronautique et les semiconducteurs.

Riche de plus de 150 ans d'histoire avec le Groupe Dehon, Inventec s'est toujours efforcé d'anticiper les exigences réglementaires, garantissant ainsi à ses clients des solutions fiables et durables.

L'IFTEC (institut IFTEC) est un centre de ressources et de formation, créé en 1967, sur les techniques et technologies de fabrication des cartes électroniques. Acteur majeur de la formation et des certifications IPC avec plus de 26 000 ingénieurs, techniciens et opérateurs formés au cours des 20 dernières années, l'institut fait monter en compétence les acteurs de l'industrie électronique dans ses ateliers équipés de matériels professionnels. L'IFTEC propose également des travaux d'expertise dans son laboratoire d'analyse.

CONTACT PRESSE

Contact événement : partenariat@slam-conference-electronique.fr

Site : www.slam-conference-electronique.fr

SLAM Conference est co-organisé par IFTEC, Inventec Performance Chemicals et We Network, avec le soutien de la Fédération de l'Électronique Française.

SLAM conference est un événement co-organisé par



soutenu par



Du 25 au 27 novembre 2026 à Angers